

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】平成28年3月10日 (2016.3.10)

【公開番号】特開2014-143379(P2014-143379A)

【公開日】平成26年8月7日 (2014.8.7)

【年通号数】公開・登録公報2014-042

【出願番号】特願2013-12391(P2013-12391)

【国際特許分類】

H 0 5 K 1/18 (2006.01)

H 0 1 G 2/02 (2006.01)

H 0 1 G 2/06 (2006.01)

H 0 5 K 3/34 (2006.01)

【F I】

H 0 5 K 1/18 G

H 0 1 G 9/00 3 2 1

H 0 1 G 1/035 A

H 0 5 K 1/18 N

H 0 5 K 3/34 5 0 1 E

【手続補正書】

【提出日】平成28年1月22日 (2016.1.22)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

第 1 および第 2 の端子を備える電子部品を実装する実装基板であって、

前記第 1 の端子が前記実装基板の表面または裏面に配置され、

前記第 2 の端子が、前記第 1 の端子が配置された面と反対側の面に配置されることを特徴とする実装基板。

【請求項 2】

前記第 1 の端子が、前記実装基板の表面または裏面から前記実装基板を貫通して、貫通先の面に配置され、

前記第 2 の端子が、前記実装基板の表面または裏面のうち、前記第 1 の端子の貫通元の面と異なる面から前記実装基板を貫通して、貫通先の面に配置される

ことを特徴とする請求項 1 に記載の実装基板。

【請求項 3】

第 1 および第 2 の端子を備える電子部品を実装する実装基板であって、

前記第 1 の端子または第 2 の端子が、前記実装基板の表面または裏面から前記実装基板を貫通し、貫通先の面に配置され、

前記第 1 および第 2 の端子のうち、前記貫通して貫通先の面に配置された端子とは異なる端子が、前記貫通先の面と同じ面に配置される

ことを特徴とする実装基板。

【請求項 4】

前記電子部品が、絶縁板に接着剤で固定される

ことを特徴とする請求項 1 乃至 3 のいずれか 1 項に記載の実装基板。

【請求項 5】

前記電子部品の一部を落とし込んで実装する開口部を備える
ことを特徴とする請求項 1 乃至 4 のいずれか 1 項に記載の実装基板。

【請求項 6】

前記電子部品は、電解コンデンサであり、
前記第 1 の端子は、陽極端子であり、
前記第 2 の端子は、陰極端子である
ことを特徴とする請求項 1 乃至 5 のいずれか 1 項に記載の実装基板。

【請求項 7】

前記実装基板は、プリント配線基板である
ことを特徴とする請求項 1 乃至 6 のいずれか 1 項に記載の実装基板。

【請求項 8】

前記実装基板の表面または裏面に配置され、前記第 1 の端子が配置される第 1 の接続部と、
前記第 1 の端子が配置された面と反対側の面に配置され、前記第 2 の端子が配置される第 2 の接続部と、を備える
ことを特徴とする請求項 1 乃至 7 のいずれか 1 項に記載の実装基板。

【請求項 9】

第 1 および第 2 の端子を備える電子部品を実装基板に実装する方法であって、
前記第 1 の端子を前記実装基板の表面または裏面に配置する第 1 工程と、
前記第 2 の端子を前記第 1 の端子が配置された面と反対側の面に配置する第 2 工程とを有する
ことを特徴とする電子部品の実装方法。

【請求項 10】

前記第 1 工程では、前記第 1 の端子を、前記実装基板の表面または裏面から前記実装基板を貫通させ、貫通先の面に配置し、
前記第 2 工程では、前記第 2 の端子を、前記実装基板の表面または裏面のうち、前記第 1 の端子の貫通元の面と異なる面から前記実装基板を貫通させ、貫通先の面に配置する
ことを特徴とする請求項 9 に記載の電子部品の実装方法。

【請求項 11】

第 1 および第 2 の端子を備える電子部品を実装基板に実装する方法であって、
前記第 1 の端子または第 2 の端子を、前記実装基板の表面または裏面から前記実装基板を貫通させ、貫通先の面に配置する第 1 工程と、
前記第 1、第 2 の端子のうち、前記貫通して貫通先の面に配置された端子とは異なる端子を、前記貫通先の面と同じ面に配置する第 2 工程とを有する
ことを特徴とする電子部品の実装方法。

【請求項 12】

前記電子部品を、絶縁板に接着剤で固定する工程を有する
ことを特徴とする請求項 9 乃至 11 のいずれか 1 項に記載の電子部品の実装方法。

【請求項 13】

前記電子部品の一部を前記実装基板の開口部に落とし込んで実装する工程を有する
ことを特徴とする請求項 9 乃至 12 のいずれか 1 項に記載の電子部品の実装方法。

【請求項 14】

前記電子部品は、電解コンデンサであり、
前記第 1 の端子は、陽極端子であり、
前記第 2 の端子は、陰極端子である
ことを特徴とする請求項 9 乃至 13 のいずれか 1 項に記載の電子部品の実装方法。

【請求項 15】

前記実装基板は、プリント配線基板である
ことを特徴とする請求項 9 乃至 14 のいずれか 1 項に記載の電子部品の実装方法。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0008

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0008】

本発明の一実施形態の実装基板は、第1および第2の端子を備える電子部品を実装する実装基板であって、前記第1の端子が前記実装基板の表面または裏面に配置され、前記第2の端子が、前記第1の端子が配置された面と反対側の面に配置される。